技术创新需求调查表

|  |
| --- |
| **企业信息** |
| 企业名称 | 第三届中国创新挑战赛（上海）组委会 | 机构代码 |  |
| 区 域 |  | 联系人 | 唐旭东 | 电话 | 13917662089 |
| 行业领域 |  | 产业领域 |  |
| 经济规模 |  | 人员规模 |  |
| **需求信息** |
| 技术需求情况说明 | 技术需求类别 | ☑技术研发（关键、核心技术）□产品研发（产品升级、新产品研发）□技术改造（设备、研发生产条件）☑技术配套（技术、产品等配套合作） |
| 技术需求简述 | 与国内铜材厂展开高性能铜合金的开发，实现高性能铜合金的本土化，能够满足电子连接器技术市场需求。  |
|  | 技术需求详述 | （包括主要技术、条件、成熟度、成本等指标）项目背景：随着电子连接器全球市场需求的持续增长，特别是在新能源汽车连接器领域，对高性能铜合金的开发需求也在不断增加。在一些高压连接器中，往往需要考虑导电率，抗应力松弛性，耐腐蚀性，折弯性能等多方面因素；目前主要铜材基本从国外引进，一些特殊铜材还受到国外管控，周期较长。 需求内容：与国内铜材厂展开高性能铜合金的开发； 达到的效果：实现高性能铜合金的本土化，能够满足电子连接器技术市场需求。  |
| 现有基础情况 | （企业已经开展的工作、所处阶段、投入资金和人力、仪器设备、生产条件等）急需与铜材供应商展开技术合作，配合完成电子连接器用高性能合金的开发，希望建立合作平台(孵化基地)，需要政府提供支持。 |
| 产学研合作需求 | 需求描述 | （希望与哪类高校、科研院所开展产学研合作，共建创新载体，以及对专家及团队所属领域和水平的要求） |
| 合作方式 |  □技术转让 □技术入股 ☑联合开发 □委托研发  □委托团队、专家长期技术服务 □共建新研发、生产实体 |
| 其他需求 | □技术转移 □研发费用加计扣除 □知识产权 □科技金融 □检验检测 □质量体系 □行业政策 □科技政策 □招标采购 □产品/服务市场占有率分析 □市场前景分析 □企业发展战略咨询 ☑其他 无  |
| **管理信息** |
| 同意公开需求信息 |  ☑是 □否 □部分公开(说明）  |
| 同意接受专家服务 |  ☑是  □否 |
| 同意参与对解决方案的筛选评价 |  ☑是 □否 |
| 同意对优秀解决方案给予奖励 |  □是，金额 万元。（奖金仅用作奖励现场参赛者，不作为技术转让、技术许可或其他独占性合作的前提条件） ☑否 法人代表： 年 月 日 |